



半导体新闻周报

汇报时间：2025.10.17

目 录

一. 沃特股份收购华尔卡密封件，半导体材料布局再升级.....	3
二. 莫纳什大学成功开发新型微型流体芯片	6
三. 厚度突破35mm！国产12吋SiC又有新突破.....	7
四. 理想&芯联：SiC MOS晶圆开启量产交付.....	9
五. 鸿海与英伟达携手推动高雄AI工厂建设.....	12
六. OpenAI与博通合作开发10GW定制AI芯片.....	15
七. 铠侠与闪迪日本北上Fab2工厂投入运营，预计2026年上半年量产	18
八. 瀚天天成：8吋SiC需求将超380万片.....	21
九. 英特尔推出新一代数据中心GPU“Crescent Island”	23
一〇. 投资10亿元，年产600万片高精密晶圆基板扩建项目奠基.....	25

①沃特股份收购华尔卡密封件，半导体材料布局再升级



2025. 10. 13

近日，深圳市沃特新材料股份有限公司（简称“沃特股份”）宣布，公司董事会审议通过以2571.6万元人民币（含税）现金收购日本株式会社华尔卡所持有的华尔卡密封件制品（上海）有限公司100%股权，该事项已获得股东大会审批，目前正办理工商变更手续，交易将使华尔卡密封件成为沃特股份全资子公司。

华尔卡密封件制品（上海）有限公司成立于2000年，是日本华尔卡在上海松江出口加工区的核心制造基地，专注于高端波纹管密封件等产品，广泛服务全球知名半导体设备及核能客户，拥有先进的生产技术和管理体系。此次收购将助力沃特股份实现半导体核心材料与关键部件一体化布局，提升整体解决方案与产能优势，增强公司在国内外半导体供应链中的竞争实力。

沃特股份目前已与多家全球半导体设备龙头企业建立合作，其聚四氟乙烯（PTFE）等氟材料以优异的耐高低温、耐腐蚀和洁净特性，成为制造刻蚀机等关键设备的核心材料。



来源：全球半导体观察

- 深圳市沃特新材料股份有限公司
- 成立时间：2001年12月28日
- 地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房
- 官网：<https://www.wotlon.com/>
- 股东信息：

深圳市银桥投资有限公司	14.24%
吴宪	13.77%
何征	13.34%
毛顺华	1.03%
深圳市沃特新材料股份有限公司	0.84%
邹志红	0.69%
陈粤一	0.39%
梁利勇	0.33%
徐晟	0.31%
梁祝萍	0.27%

WOTE 沃特股份
002886

- 华尔卡密封件制品（上海）有限公司
- 成立时间：2000年12月21日
- 地点：上海松江出口加工区南乐路111号
- 官网：<https://www.valqua-vssh.cn/>
- 股东信息：

株式会社华尔卡 100% 115,000万(日元)

- 华尔卡密封件制品（上海）有限公司是日本株式会社华尔卡于2000年在上海设立的外商独资企业，隶属于华尔卡集团全球生产体系，定位为集团在华第二大生产基地。公司专注于高性能密封件制品的研发与制造，主要产品包括金属焊接波纹管、内衬储罐、高性能弹性体和ISO槽车等，业务服务涵盖半导体、汽车、航空航天等高端制造领域。



②莫纳什大学成功开发新型微型流体芯片

2025. 10. 13

莫纳什大学研究团队近日宣布成功开发出一种新型微型流体芯片，其运作原理模仿人脑神经通路，这一突破或将为下一代类脑计算机研发开辟新方向。

该芯片大小约相当于一枚硬币，采用了特殊设计的金属有机框架（Metal-Organic Framework, MOF）纳米多孔材料，该材料具高度调控性能和导电性。芯片通过微小通道传输离子，以模拟传统计算机中电子晶体管的开关功能。不同于传统芯片，这种微流体芯片还具有“记忆”能力，能存储之前的信号，展现出类似于大脑神经元的可塑性。

王焕庭教授指出：“我们首次在纳米流体装置中观察到质子的饱和非线性传导，这为设计拥有记忆乃至学习功能的离子电子系统开启了新途径。若能将MOF材料制备至仅几纳米厚，将能开发出更为先进的流体芯片，从而突破目前电子芯片的性能瓶颈。”



来源：全球半导体观察

③厚度突破35mm！国产12吋SiC又有新突破

2025. 10. 13

天成半导体继第二季度研制出12英寸N型碳化硅单晶材料后，又依托自主研发的12英寸碳化硅长晶设备，成功研制出12英寸高纯半绝缘碳化硅单晶材料，12英寸N型碳化硅单晶材料晶体有效厚度突破35mm厚。

天成半导体现已掌握12英寸高纯半绝缘和N型单晶生长双成熟工艺，且自研的长晶设备可产出直径达到350mm的单晶材料。

近年来，天成半导体不断迭代产品工艺，在大尺寸、低成本量产方面实现关键技术突破，率先研发出可量产的8-12英寸导电型和半绝缘型碳化硅单晶材料，产品质量达到国际领先水平。

截至目前，天成半导体已形成了碳化硅单晶炉制造、碳化硅粉料制备、6-12英寸碳化硅单晶材料生长、生产耗材加工等完整的生产线。实现了从碳化硅长晶设备制造、粉料、籽晶、热场设计到晶体加工等全流程工艺完全自主可控。.



来源：行家说三代半

- 山西天成半导体材料有限公司
- 成立时间：2021年08月04日
- 地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区不锈钢产业园区钢园北街1号(一照多址)
- 官网：<https://www.tcsic.cn/>
- 股东信息：

山西合创天成科技集团有限公司	62.451%	832.68万
山西华川半导体科技发展院	15.948%	212.64万
宁波云璞创业投资合伙企业	6%	80万
刘洋洋	5.4005%	72.0066万
宁波梅山保税港区云翼创业投资合伙企业	4%	53.3333万
李淑芳	2.7%	36万
张利勇	2%	26.6667万
太原景铄天成科技发展中心	1.5005%	20.0067万



2025. 10. 13

10月13日，**芯联集成**在官微宣布，近日他们与**理想汽车**举办了**理想&芯联集成合作伙伴交流会暨BAREDIE晶圆下线仪式**，标志着双方在碳化硅产品领域的深度合作取得了重大阶段性成果。芯联集成董事长、总经理赵奇，理想汽车供应链高级副总裁孟庆鹏等公司高层共同出席本次活动。

芯联集成表示，自2024年3月正式签署战略合作框架协议以来，两家公司在碳化硅技术上展开了全面且深入的合作。历经一年多的紧密协作，由理想汽车设计开发、芯联集成代工量产的碳化硅产品现已开启量产交付。

此次量产交付的碳化硅产品，标志着双方战略协同迈入新阶段，也是理想纯电战略落地的关键一环。未来，该产品将在理想i系列纯电车型上搭载。“行家说三代半”了解到，“i系列”是理想汽车在今年推出的全新纯电SUV系列，与“L系列”、“MEGA系列”并序，目前已推出i8、i6两款车型。



来源：行家说三代半

- 芯联集成电路制造股份有限公司
- 成立时间：2018年3月9日
- 官网：<https://cn.unt-c.com/index.html>
- 地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号
- 股东信息：

绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业	16.3%
中芯国际控股有限公司	14.06%
招商银行股份有限公司	3.76%
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业	3.26%
绍兴日芯锐企业管理合伙企业	3.06%
中国工商银行股份有限公司	2.9%
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业	1.53%
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	1.46%
富诚海富资管—兴业银行	1.37%
宁波振芯股权投资合伙企业	1.07%



- 理想汽车 Li Auto
- 成立时间：2015年7月1日
- 官网：<https://www.lixiang.com/>
- 地址：北京
- 理想汽车，是中国新能源汽车制造商，设计、研发、制造和销售豪华智能电动汽车，由李想创立于2015年7月，总部位于北京，自有生产基地位于江苏常州，理想汽车通过产品创新及技术研发，为家庭用户提供安全及便捷的产品及服务。



⑤鸿海与英伟达携手推动高雄AI工厂建设

2025. 10. 14

在2025年10月13日于美国加州圣荷西举行的开放运算计划全球峰会（OCP Global Summit 2025）上，**鸿海科技集团**宣布将与**英伟达（NVIDIA）**合作，在台湾高雄推动**800V HVDC**电力架构的导入，打造未来的AI工厂（AI Factory）基础设施。

鸿海在新闻稿中指出，这一**800V HVDC**电力架构将首先在高雄的**K-1专案AI资料中心**实施，这一专案被视为鸿海推动AI产业升级的重要里程碑，将成为集团在AI服务器、资料中心及再生能源整合应用方面的示范基地。

随着AI工厂的诞生，鸿海表示产业正迈入高密度与高效能的新时代。透过与英伟达及其生态系的技术合作，鸿海不仅在K-1专案中率先导入**800V HVDC**架构，还将持续强化在AI服务器、电力与冷却整合设计方面的实力，目标是打造安全、节能且可快速部署的AI资料中心解决方案。

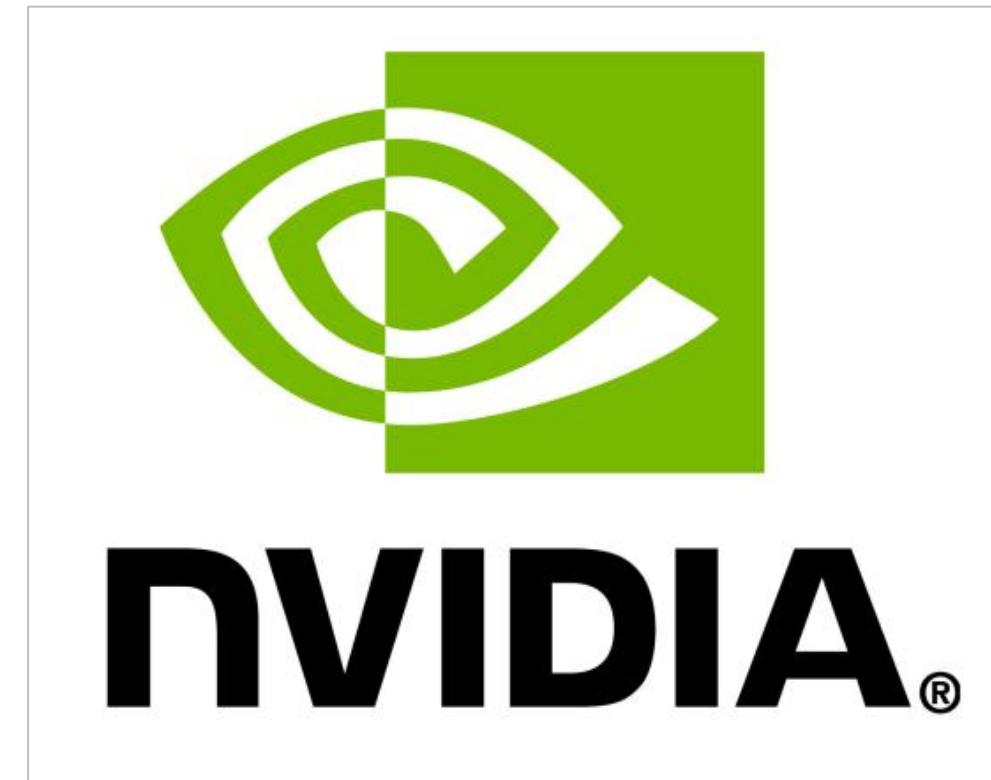


来源：全球半导体观察

- 鸿海精密工业股份有限公司
- HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.
- 成立时间：1974年2月20日
- 地点：中国台湾省新北市土城区中山路66号
- 官网：<https://www.honhai.com/zh-tw>
- 集团多年来致力于研发创新，以核心技术为中心，包括：纳米技术、环保制程技术、平面显示器技术、无线通讯技术、精密模具技术、伺服器技术、光电/光通讯技术材料与应用技术及网路技术等。集团不仅具完善的研发管理制度，更在知识产权管理上努力耕耘，积极地以提升华人之国际竞争力为己任。



- 英伟达 NVIDIA
- 成立时间：1993年4月5日
- 地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市
- 官网：<https://www.nvidia.cn/>
- 公司早期专注于图形芯片设计业务，随着公司技术与业务发展，已成长为一家提供全栈计算的人工智能公司，致力于开发CPU、DPU、GPU和AI软件，为建筑工程、金融服务、科学研究、制造业、汽车等领域的计算解决方案提供支持。
- NVIDIA曾获世界人工智能大会的最高奖项“卓越人工智能引领者”。2020年7月，NVIDIA首次在市值上超越英特尔，成为美国市值最高的芯片厂商。2023年5月，成为首家市值达到1万亿美元的芯片企业。



⑥OpenAI与博通合作开发10GW定制AI芯片

2025. 10. 14

在资本市场上，**OpenAI**与**博通（Broadcom）**之间的合作引发了广泛关注。根据2025年10月13日的公告，这两家公司将共同开发10吉瓦（GW）规模的定制AI芯片和网络系统机架。此消息一经发布，博通的股价在周一开盘后上涨近10%，市值增加超过1500亿美元。

博通首席执行官陈福阳在上个月的财报会议上曾暗示将有“新的大买家”加入，预计**2026财年**的人工智能收入将显著改善。尽管博通在9月曾披露收到一份来自匿名客户的**100亿美元**定制芯片订单，但博通的半导体解决方案集团总裁查理·卡瓦斯表示，该订单与**OpenAI**无关。

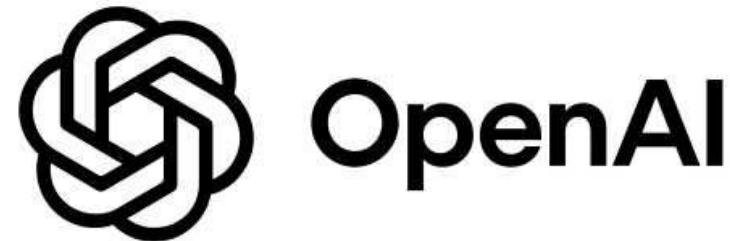
根据双方的联合声明，**OpenAI**将主导芯片和系统的设计，而博通则负责联合开发和部署。两家公司计划于2026年下半年开始部署，预计在2029年底前完成全部部署。



来源：全球半导体观察

15

- 美国开放人工智能研究中心
- OpenAI
- 成立时间：2015年12月11日
- 地点：美国旧金山
- 官网：<https://openai.com/zh-Hans-CN/>
- OpenAI，是一家开放人工智能研究和部署公司，其使命是确保通用人工智能造福全人类。创立于2015年12月，总部位于美国旧金山。现由营利性公司OpenAI LP及非营利性母公司OpenAI Inc组成。



- 博通公司 Broadcom Corporation
- 成立时间：1991年
- 总部地点：美国加利福尼亚州尔湾市
- 官网：<https://www.broadcom.cn/>
- Broadcom Inc. 是一家全球领先的技术企业，业务范围囊括多种半导体、企业用软件和安全解决方案的设计、开发和供应。Broadcom 的类别领先产品组合在许多重要的市场中发挥作用，其中包括云、数据中心、网络、带宽、无线技术、存储，以及工业和企业用软件。我们的解决方案包括服务提供程序、企业网络与存储、移动设备和带宽链接、大型主机、网络安全，以及私有云和混合云架构。



2025. 10. 14

近日，**Kioxia**（铠侠）和**Sandisk**（闪迪）宣布其位于日本岩手县北上工厂的先进半导体制造工厂—Fab2（K2）正式投入运营。

铠侠介绍称，Fab2能够生产第八代218层3D闪存，采用公司革命性的CBA（CMOS直接键合阵列）技术，并支持未来先进的3D闪存节点，以满足人工智能（AI）驱动的存储市场日益增长的需求。Fab2的产能将根据市场趋势逐步提升，预计将于2026年上半年实现量产。

此外，Fab2工厂采用减震建筑结构，并配备最先进的节能制造设备。该工厂利用人工智能提高生产效率，采用节省空间的设施设计，扩大了洁净室中制造设备的可用空间。根据2024年2月获批的计划，Fab2的部分投资将由日本政府补贴。

负责运营北上工厂的铠侠岩手株式会社总裁兼首席执行官柴山耕一郎表示：“我们很高兴在北上工厂启用新的Fab2工厂。Fab2生产的第一代及后续3D闪存产品将为快速崛起的人工智能市场创造新的价值。”



来源：行家说三代半

- 铠侠股份有限公司旗下品牌
- 官网: <https://www.kioxia.com.cn/zh-cn/top.html>
- 铠侠 (KIOXIA) 主要从事闪存 (FLASH) 及固态硬盘 (SSD) 开发、生产和销售。 [1] 铠侠的前身是东芝存储器集团，东芝公司在1987年发明了NAND闪存。 [15] 2019年10月，公司更名为铠侠株式会社。 [14]
- 铠侠以其创新的BiCS FLASH™ 3D闪存技术为核心，服务于高级智能手机、个人电脑、固态硬盘、汽车电子和数据中心等领域。致力于通过先进的存储技术丰富人们的生活，扩展社会的视野。铠侠的零售产品包括存储卡、闪存盘及固态硬盘等，旨在为终端用户提供高质量的存储解决方案，使他们能够随时随地存储和管理其数字生活。



- 闪迪 SanDisk
- 成立时间：1988年
- 总部地点：米尔皮塔斯
- 官网：<https://shop.sandisk.com/zh-cn>
- SanDisk（闪迪）公司是全球最大的闪速数据存储卡产品供应商。1988年诞生于美国加利福尼亚州帕罗奥多，该公司由非易失性存储技术领域的国际权威Harari Eli博士在1988年创立。1995年11月，闪迪成为了一家公开上市的公司，其纳斯达克股票代码为SNDK。2004年，闪迪公司收入达到18亿美元。公司在全球范围内拥有超过5000名雇员。公司总部设在美国加利福尼亚州的米尔皮塔斯市。闪迪的产品正通过全球26万多家零售店出售。
- 闪迪的亚太地区总部位于中国香港。闪迪也在上海、台北和首尔设有销售办事处，并通过原始设备制造商（OEM）渠道和包括中国大陆、中国台湾、韩国、新加坡、泰国和菲律宾在内的众多亚洲国家和地区的分销商和零售商网络销售其产品。



2025. 10. 15

根据[瀚天天成](#)招股书，他们预计2029年全球8英寸碳化硅外延销量将由2024年10万片增至380万片，年复合增长率为94.2%。其中，全球前五大碳化硅芯片制造商已共同投入超过250亿美元，用于8英寸碳化硅功率器件生产线，预计各产线在全面投产后将创造超过200片8英寸外延片的需求量。

截至2025年5月31日，瀚天天成已与全球18家企业（其中包括全球前十大行业巨头的三家）建立8英寸产品合作伙伴关系。为此，他们计划扩大8英寸碳化硅外延芯片的产能，预计2029年8英寸产能将达到每年46.3万片，并且在完成升级改造和人员招聘后，预计2029年厦门生产基地的利用率将超过70%。

营收方面，该招股书显示，瀚天天成2025年1-5月的碳化硅外延营收为2.66亿元，营收和毛利率同比2024年1-5月有所下滑。



来源：行家说三代半

- 瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司
- Hantiantiancheng Electronic Technology (Xiamen) Co., Ltd.
- 成立时间：2011年3月31日
- 地点：厦门火炬高新区同翔高新城头东二路198-1号
- 官网：<https://www.epiworld.com.cn/>
- 股东信息：

赵建辉	30.65105%	11,898.4956万
厦门希科众恒投资合伙企业	14.61888%	5,674.9358万
李庆华	6.96045%	2,701.9903万
厦门芯成众创投资合伙企业	4.25148%	1,650.3914万
哈勃科技创业投资有限公司	4.19698%	1,629.235万
厦门中南弘远股权投资基金合伙企业	4.14907%	1,610.636万
厦门瀚天核芯企业管理合伙企业	4.11366%	1,596.8888万
海南臻泰创业投资合伙企业	3.98813%	1,548.1611万
黄山赛富旅游文化产业发展基金	2.79799%	1,086.1566万



⑨英特尔推出新一代数据中心GPU“Crescent Island”

2025. 10. 15

在2025年10月14日的OCP全球峰会上，**英特尔**正式发布了其新一代数据中心GPU，代号为“Crescent Island”。该产品专为满足日益增长的人工智能推理工作负载而设计，搭载了**英特尔**的Xe3P微架构，并配备了高达160GB的LPDDR5X内存。此款GPU的推出标志着英特尔在数据中心GPU领域的又一次重要进展。

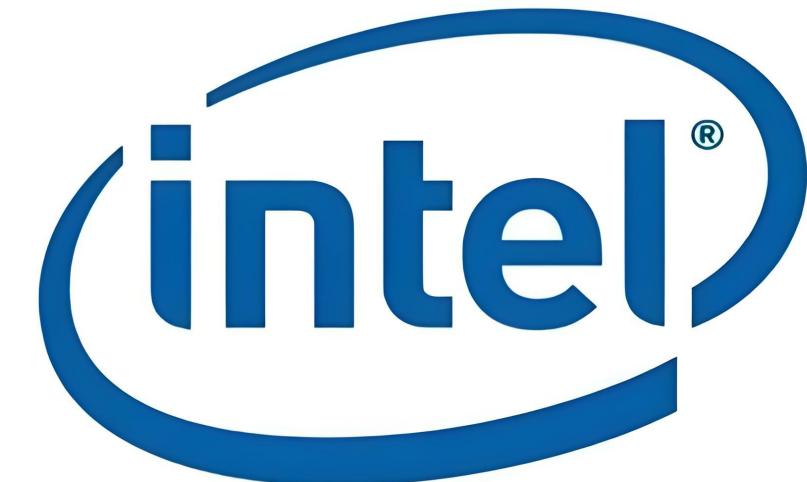
“Crescent Island” GPU的设计旨在优化功耗和成本，特别适合用于空气冷却的企业服务器。根据英特尔的介绍，该GPU将支持多种与推理工作负载相关的数据类型，尽管目前尚未透露其具体性能指标。该产品预计将在2026年下半年开始客户测试，2027年有望量产。英特尔可能会在OCP会议或SC25贸易展上分享更多性能细节。

值得注意的是，这款GPU的内存配置相当高，160GB的LPDDR5X内存远超一般显卡的预期。



来源：全球半导体观察

- 英特尔
- 成立时间：1968年
- 总部地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市
- 官网：
<https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/homepage.html>
- 英特尔是半导体行业和计算创新领域的全球领先厂商，创始于1968年。2023财年收入为542亿美元。如今，英特尔正转型为一家以数据为中心的公司。英特尔与合作伙伴一起，推动人工智能、5G、智能边缘等转折性技术的创新和应用突破，驱动智能互联世界。



2025. 10. 15

百盛光电官微消息，10月11日上午，浙江百盛光电股份有限公司年产600万片高精密晶圆基板扩建项目正式举行培土奠基仪式。

据悉，此次奠基的扩建项目，是百盛光电布局半导体关键材料领域的重要一步，总投资达10亿元，总用地面积48.3亩，将新建5.2万平方米高标准建筑，涵盖生产厂房、仓储中心及研发中心，构建“研发+生产+仓储”一体化的产业空间。

项目建成后，将形成年产600万片高精密晶圆基板的产能，而高精密晶圆基板作为芯片封装的关键材料，将进一步填补区域半导体产业链关键环节空白，达产后预计年产值达10.8亿元。

公开资料显示，百盛光电成立于2000年，产品包括压电和光学、晶圆、硫系小球、蓝玻璃、手机盖板六大系列产品。其中压电 SC 产品出货量全球前三，蓝玻璃产能达到全国第一，晶圆产品已进入先进封装、MEMS、泛半导体光学、AR、光通讯等领域。



来源：行家说三代半

- 浙江百盛光电股份有限公司
- 成立时间：2011年06月24日
- 总部地点：浙江省嘉兴市南湖区余新镇新盛路262号1幢
- 官网：<http://www.bestoc.cn/equ/?jianjie/>
- 股东信息：

陈时兴

44.08456% 2,800万

陈林英

31.48897% 2,000万

褚叶文

18.89338% 1,200万

嘉兴兴望企业管理合伙企业

5.53309% 351.43万





Thank you

- 🏠 江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼26楼01室(江宁开发区)
- 📞 TEL:025-84148808 (09:00-17:30)
- ✉️ E-Mail:info@bosikst.com
- 🌐 URL:<https://www.bosikst.com>